

# Interscale Flexible Heat Conductor (FHC), 20 mm

## Power Utilities



Conductor block expands/contracts vertically to compensate for tolerance stack up and optimizes surface contact and pressure along the thermal path; eliminates the need for a thermal gap pad.

### ZERTIFIZIERUNGEN



### MERKMALE

Designed for Intel, AMD, Via, Freescale, NVidia and Texas Instrument processors that employ a BGA socket

Provides industry-leading conduction cooling performance, 10% improvement over current conduction cooling methods

Patent pending conduction cooling solution for small form factor electronics

Secured to PCB with thermally conductive adhesive tape

Conductor block expands/contracts vertically to compensate for tolerance stack up and optimizes surface contact and pressure along the thermal path; eliminates the need for a thermal gap pad

Compatible with Interscale C enclosures

### SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

| Katalognummer | Typ | Passt zu | Anzahl Verpackungen | Tiefe | Breite |
|---------------|-----|----------|---------------------|-------|--------|
|---------------|-----|----------|---------------------|-------|--------|

|           |             |         |   |       |       |
|-----------|-------------|---------|---|-------|-------|
| 24830-005 | Wärmeleiter | Gehäuse | 1 | 22 mm | 22 mm |
|-----------|-------------|---------|---|-------|-------|

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**